



FATC 記憶體最佳代工夥伴

福懋科技 2022年法人說明會

總經理暨發言人 張憲正

2022年8月24日

免責聲明

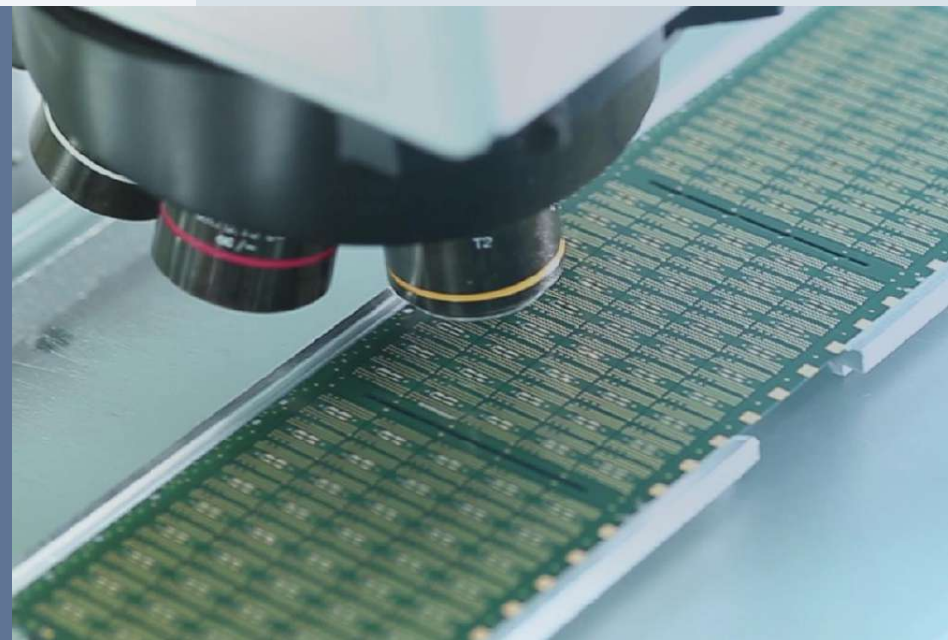
簡報內容（含本會議中所揭露之資訊）含有若干預測性資訊，僅供參考之用。福懋科技股份有限公司或任何第三人均不就該預測性資訊之正確性與完整性承擔任何責任，亦不負更新或更正該資訊之義務，請您務必謹慎審閱以上資訊。如未經許可，亦請您切勿散播、重製或揭露以上資訊之一部分或全部予第三人。

會議議程

- 1 2022年上半年營運績效及財務狀況
- 2 研究發展規劃
- 3 營運重點與市場展望
- 4 問與答

1

2022年上半年 營運績效及財務狀況



2022年上半年財務摘要

單位:新台幣仟元

會計科目	項目	2022年上半年		2021年上半年		差異	
		金額	%	金額	%	金額	%
營業收入		5,261,728	100.0	5,001,263	100.0	260,465	5.2
營業毛利		1,122,216	21.3	1,018,548	20.4	103,668	10.2
營業利益		1,000,211	19.0	914,612	18.3	85,599	9.4
稅前息前折舊攤銷前利益		2,052,476	39.0	1,636,148	32.7	416,328	25.4
稅前淨利		1,401,312	26.6	896,217	17.9	505,095	56.4
本期淨利		1,146,446	21.8	719,751	14.4	426,695	59.3
每股盈餘(元/股)		2.59		1.63		0.96	
每股淨值(元/股)		27.17		26.16		1.01	

2022年各季綜合損益表

單位:新台幣仟元

會計科目	項目	2022年Q2		2022年Q1		差異	
		金額	%	金額	%	金額	%
營業收入		2,699,094	100.0	2,562,634	100.0	136,460	5.3
營業毛利		608,027	22.5	514,189	20.1	93,838	18.2
營業利益		550,626	20.4	449,585	17.5	101,041	22.5
稅前息前折舊攤銷前利益		1,149,039	42.6	903,437	35.3	245,602	27.2
稅前淨利		824,888	30.6	576,424	22.5	248,464	43.1
本期淨利		685,307	25.4	461,139	18.0	224,168	48.6
每股盈餘(元/股)		1.55		1.04		0.51	
每股淨值(元/股)		27.17		28.74		-1.57	

2022年第2季與第1季差異說明

單位:新台幣仟元

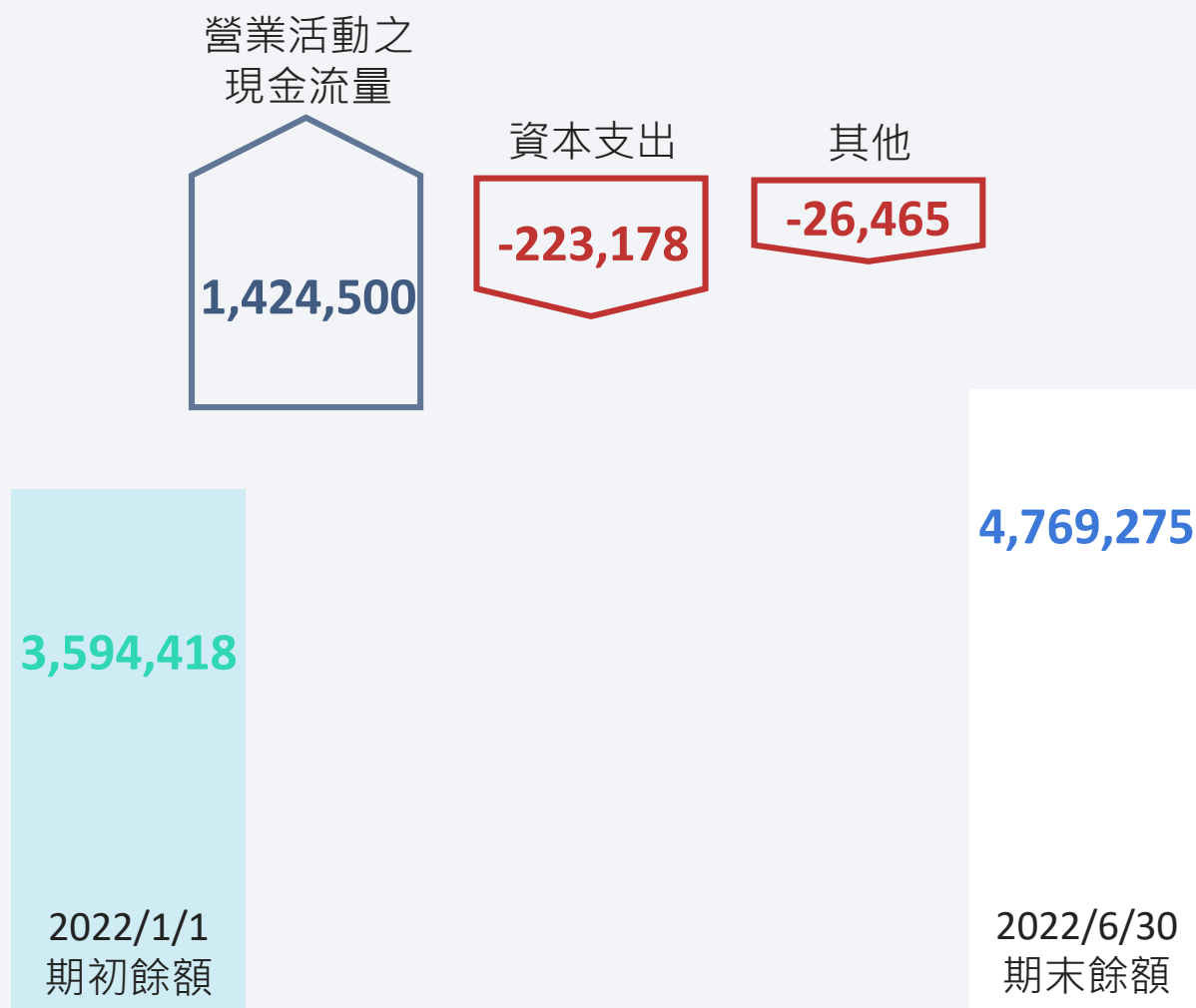
項目	2022年Q2		2022年Q1		差異		差異說明
	金額	%	金額	%	金額	%	
會計科目							
營業收入	2,699,094	100.0	2,562,634	100.0	136,460	5.3	銷售量季減低個位數百分比，平均代工單價增加中個位數百分比，匯率影響有利中個位數百分比。
營業毛利	608,027	22.5	514,189	20.1	93,838	18.2	2022年Q2毛利季增18.2%，主要係平均代工單價增加及匯率有利。
營業利益	550,626	20.4	449,585	17.5	101,041	22.5	2022年Q2營業利益季增101,041仟元，主要為毛利增加93,838仟元、推銷管理費用增加3,067仟元及研發費用漸少10,270仟元。
本期淨利	685,307	25.4	461,139	18.0	224,168	48.6	本期淨利季增224,168仟元，主要為營業利益增加101,041仟元、利息收入增加4,545仟元、兌換利益增加19,895仟元、股利收入增加129,147仟元及所得稅費用增加24,296仟元。

現金流量表

2022年上半年現金流量

單位:新台幣仟元

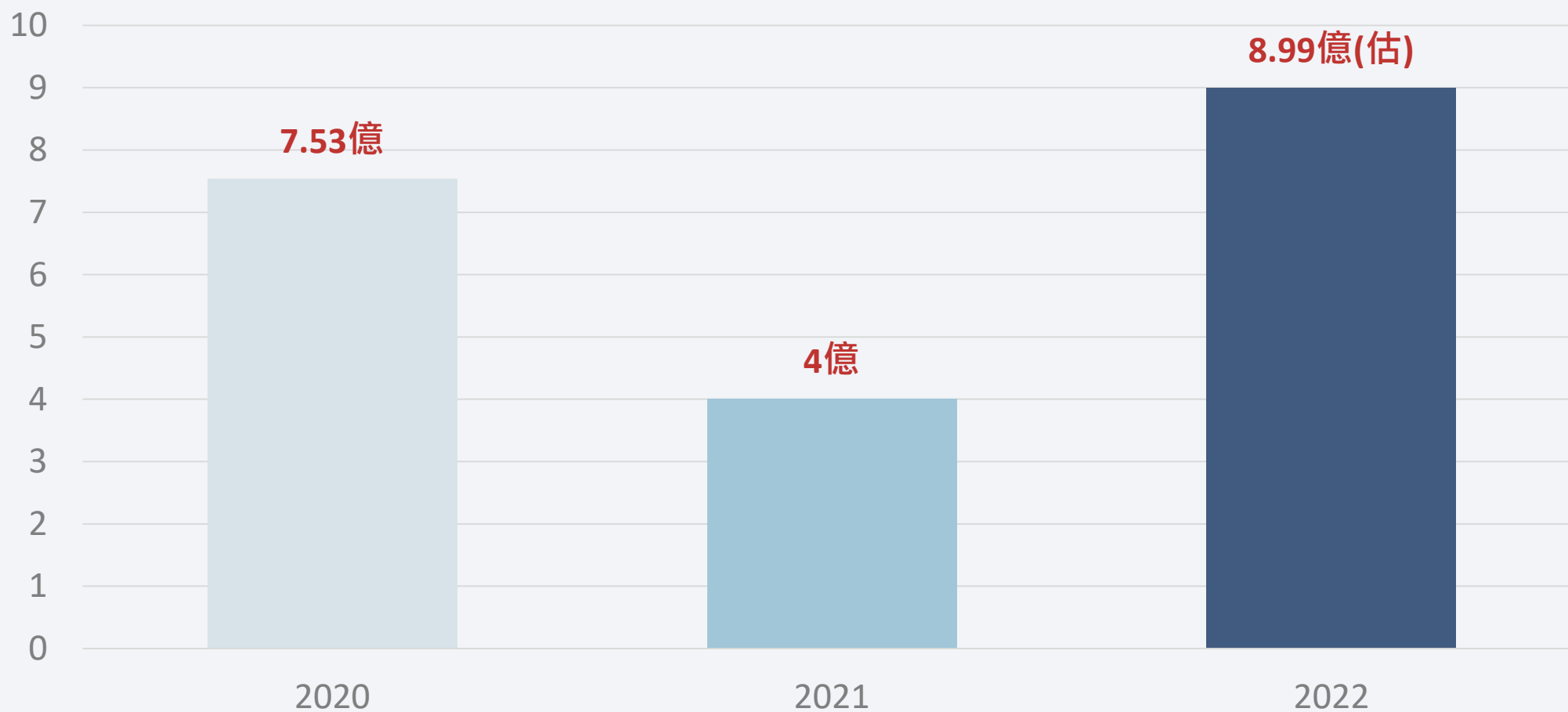
	2022年Q2	2022年Q1
期初餘額	4,118,337	3,594,418
營業活動之現金流量	716,433	708,067
資本支出	-37,941	-185,237
其他	-27,554	1,089
期末餘額	4,769,275	4,118,337
自由現金流量	678,492	522,830



2022年上半年自由現金流量為1,201,322仟元

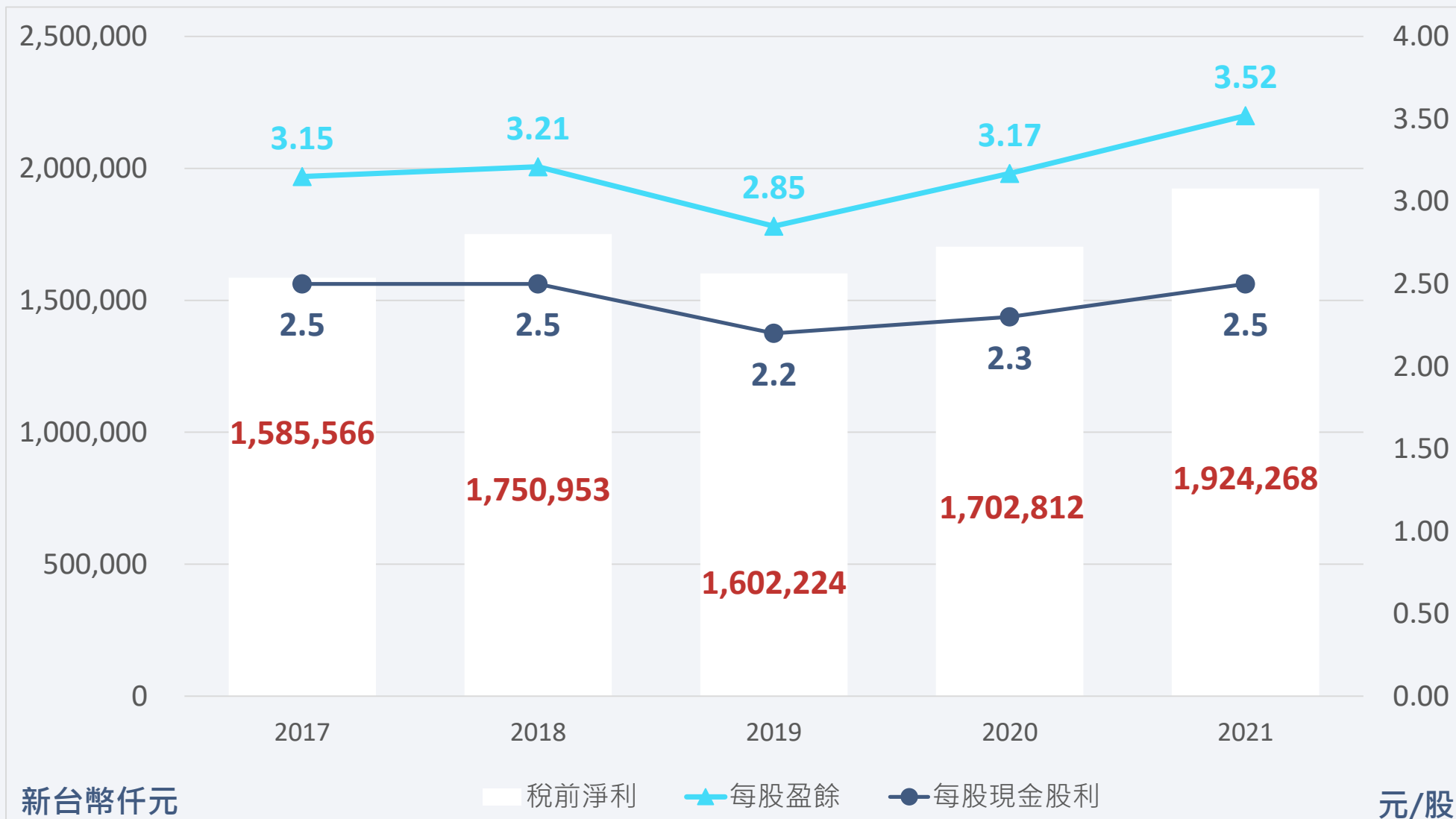
歷年資本支出

單位:新台幣億元

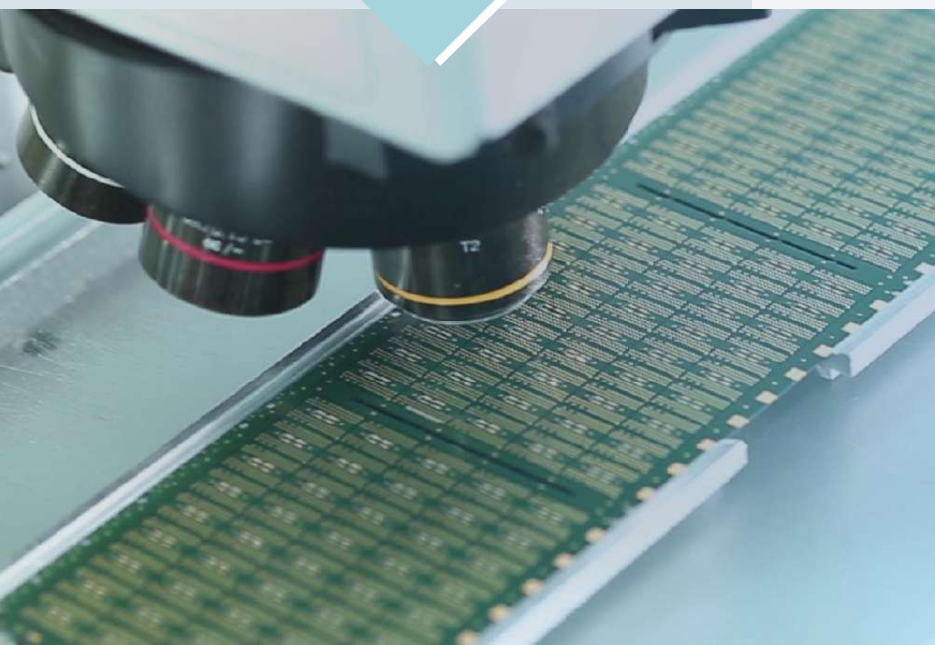


近5年之稅前淨利、稅後EPS、現金股利

單位:新台幣仟元



2



研究發展 與規劃

研究發展與規劃

記憶體晶片持續進行製程微縮，並朝向高效能發展，
福懋科技依此趨勢擬訂研發方向如下：

1

因應記憶體高速化，使用載板電路設計、高腳數銅凸塊結構及微間距封膠等技術，開發覆晶封裝技術，並運用覆晶封裝技術在DDR5產品開發上。

2

除了覆晶封裝技術持續應用在既有記憶體封測客戶外，進而延伸到邏輯領域。

3

營運重點與 市場展望



營運重點

1

已於8月19日配發2021年之現金股利，每股新台幣2.5元。

2

第二季每股盈餘新台幣1.55元；
上半年每股盈餘為新台幣2.59元。

3

福懋科五廠預計將於9月動土興建。

4

新廠將導入覆晶封裝製程及高速測試，
佈局新世代DDR5產品。

市場展望



1

受到高通膨、戰爭、疫情等影響，消費者對電子產品的購買力減弱，連帶影響對記憶體的需求亦減少。

2

NB、手機、伺服器、消費性電子產品的需求均軟弱，其所需之記憶體亦減緩，需求能見度低，但急單需求增加。

公司將彈性調整產能、縮短生產交期以協助客戶爭取訂單。

4

問與答

